

亞矽#6113 2025 第三季 法人說明會

Presentation By ASEC



免責聲明

本文件所內含之預測性資訊，其中包括財務概況、未來擴張計畫及營運策略等內容，皆為基於當前情況之預期以及對未來事件的預測。儘管本公司對未來的展望皆建立在合理的假設條件之上，這些預測性資訊依然受未知的風險、不確定性因素及其他因素之影響。

本公司不負責主動公開對未來預測性資訊之更新與修正，文件中對未來之展望，皆反應本公司截至目前為止對未來的看法。實際結果可能與本文件預測性資訊存在差異。

Agenda

1. 市場概況
2. 行業概況
3. 公司概況
4. 財務概況
5. 未來展望
6. Q&A

01

市場概況

2025年全球GDP成長3.2%

GDP排名	國家	2024 GDP 美金
1	美國	29兆1,849億
2	中國	18兆7,840億
3	德國	4兆6,585億
4	日本	4兆262億
5	印度	3兆9,091億
6	英國	3兆6,446億
7	法國	3兆1,620億
8	義大利	2兆3,721億
9	加拿大	2兆2,413億
10	巴西	2兆1,713億
	台灣	7,824億

- ✓ IMF預測2025年全球GDP成長率為**3.2%**
- ✓ 主要國家預測
 - 美國：成長 2.0%
 - 歐元區：成長 1.2%
 - 日本：成長 1.1%
 - 中國：成長 4.8%
 - 印度：成長 6.5%
 - 台灣：成長 3.7%
- ✓ 中華經濟研究院預測2025年台灣經濟成長率將達**5.45%**

台灣ICT產業2025年1-9月出口占比

單位:億美元, %

類別	期間	114年9月			114年1-9月		
		金額	占出口總額	年增率	金額	占出口總額	年增率
科技產品		417.9	77.0	47.5	3,369.0	74.4	44.1
電子零組件		214.3	39.5	25.6	1,589.3	35.1	25.4
資通與視聽產品		192.7	35.5	86.9	1,687.7	37.3	70.9
光學及精密儀器		10.8	2.0	12.5	92.0	2.0	10.8
非科技產品		124.7	23.0	2.1	1,157.8	25.6	0.5
基本金屬及其製品		21.9	4.0	-1.7	213.3	4.7	0.2
機械		20.9	3.9	5.0	188.1	4.2	5.2
化學品		14.4	2.7	1.8	138.2	3.1	0.3
塑橡膠及其製品		13.9	2.6	-7.1	137.0	3.0	-6.7
礦產品		12.2	2.2	10.2	105.0	2.3	-1.2
電機產品		12.6	2.3	17.2	110.5	2.4	12.3
運輸工具		8.3	1.5	-2.4	78.9	1.7	-2.8
紡織品		5.4	1.0	-8.6	47.4	1.0	-6.6

兆豐銀行徵信處2025/10

2025年全年預測台灣的總出口將來到6000億美金，而電子零組件與資通視聽產品將占總出口比重 **78.8%**。

ICT三大事件衝擊產業



川普關稅政策增加全球供應鏈風險

川普政府對各國產品課徵高關稅，增加了全球供應的不確定性，地緣政治壓力加大，風險顯著升高。



AI需求推動市場成長

AI應用（如生成式AI、邊緣運算、伺服器晶片）需求仍持續爆炸性成長。



TSMC重要的戰略地位

TSMC作為全球最先進晶片製造商，美國在AI與半導體的競爭中展現了對TSMC的依賴。

全球ICT產業的影響



供應鏈重組

Nvidia、Apple等因關稅與政策壓力，可能加速多元化供應鏈布局，尋求部分產能移轉或合作模式調整。



美中科技戰升級

川普政府的政策加深了美中在半導體與AI領域的對抗。台灣半導體產業成為焦點，TSMC成為重要的戰略資產。



ICT產業AI為重點

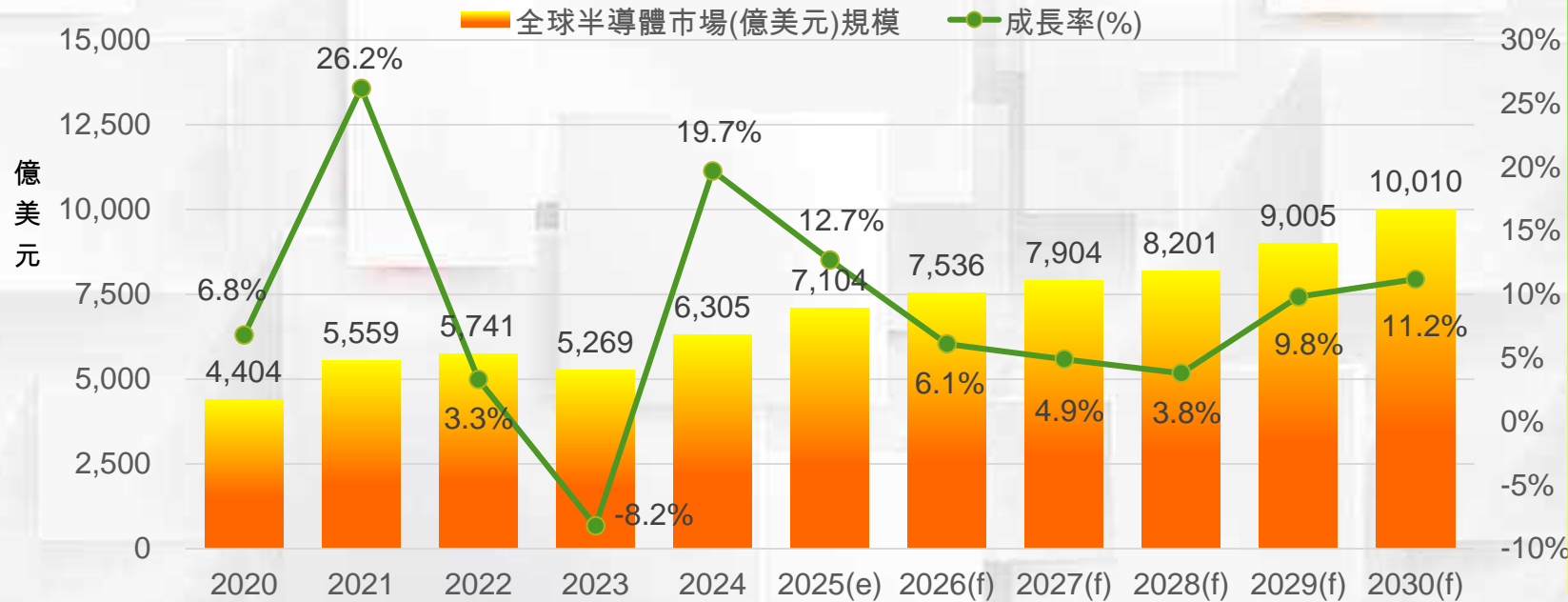
全球ICT企業在2025年更傾向投資AI基礎設施（GPU、伺服器、雲端平台），同時加強風險管理，避免過度依賴單一供應商。

2025年的全球ICT產業變動重點在於：

AI需求持續推升市場成長，但地緣政治與關稅政策使供應鏈承受壓力，**TSMC的角色更顯關鍵**，成為美中科技戰的核心棋子。

全球ICT產業市場概況

全球半導體市場(億美元)規模



資料來源：WSTS · MIC整理 · 2025年5月

- 回顧2024年：庫存調整尾聲，終端需求回溫，半導體市場回復成長軌跡，二位數成長**19.7%**
- 展望2025年：經濟不確定因素多，目前審慎樂觀預估成長**12.7%**

半導體業回升主軸仍為AI應用，從而驅動記憶體、先進製程需求爆發，帶動終端伺服器等軟硬體增長。

五大關鍵應用



全球半導體供應鏈

從美國設計、歐洲設備、日本材料到台灣製造及封測，
各具專業優勢，彼此合作無間



台灣半導體產業市場概況



工研院 2025

2024年台灣IC產業產值達**NT\$ 5兆3千億元**，成長**22%**，高於全球平均水準。展望**2025年**，在AI和高效能運算等應用需求的推動下，產值將能一舉突破**NT\$ 6兆元**，年增**16.5%**。

AI的算力掌握在台灣

未來全球AI將以每年平均42%高速成長，全仰賴台灣關鍵製造

AI晶片

100%
台灣製造



晶片設計-GPU(圖形處理器)



伺服器

90%
台灣代工生產

全球
出貨量

OEM/ODM

GIGABYTE
技嘉



wistron
緯創資通

FOXCONN
鴻海

電源供應



LITEON
光寶科技

機殼

CHENBRO
勤誠



uneeC
晟銘電

散熱



雙湖
奇銳

資料中心

雲端服務供應商(CSP)



amazon



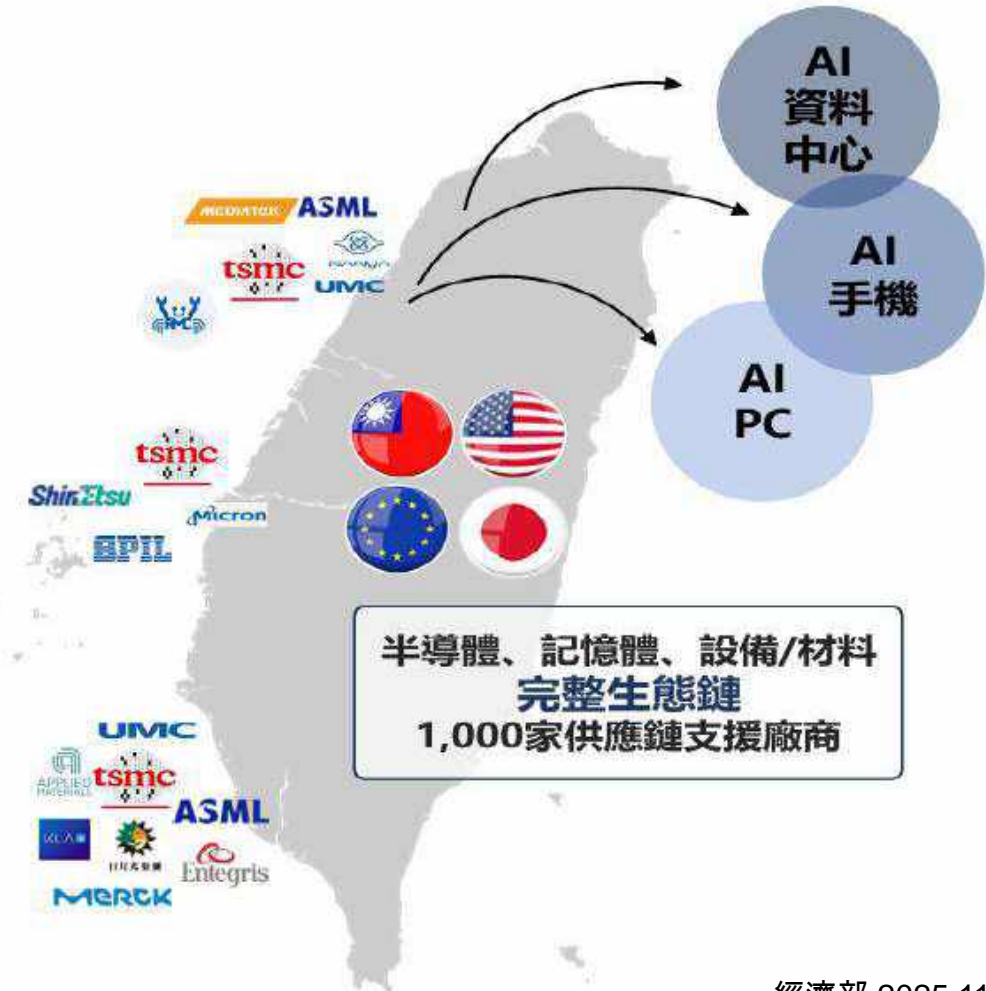
國家級研究機構



台灣最堅強ICT供應鏈

台灣效率無可取代

台灣擁有
世界密度最高
運作最具效率的
ICT產業聚落

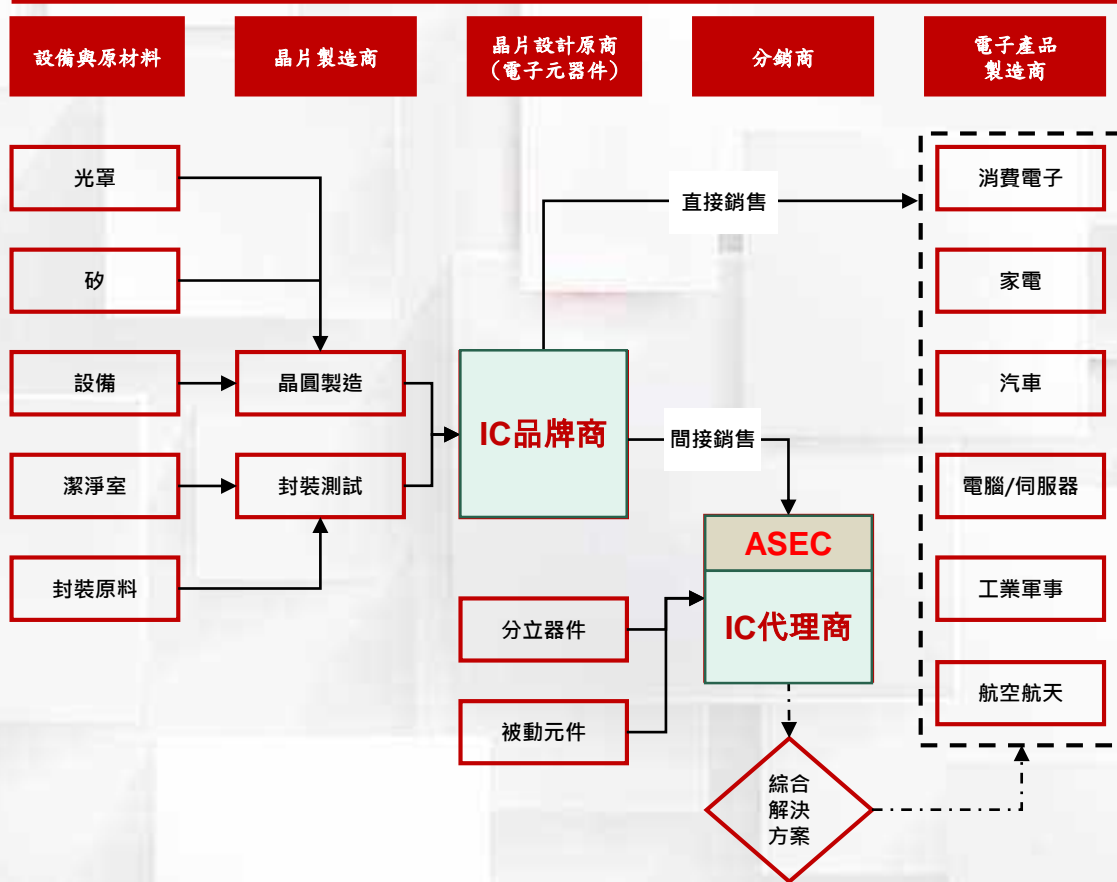


02

行業概況

IC代理行業生態架構

半導體產業鏈



代理行業的特色:

五高 > 高營收 高資本 高庫存 高負債 高風險
二低 > 低毛利 低本益比

高營收、低毛利的結構性

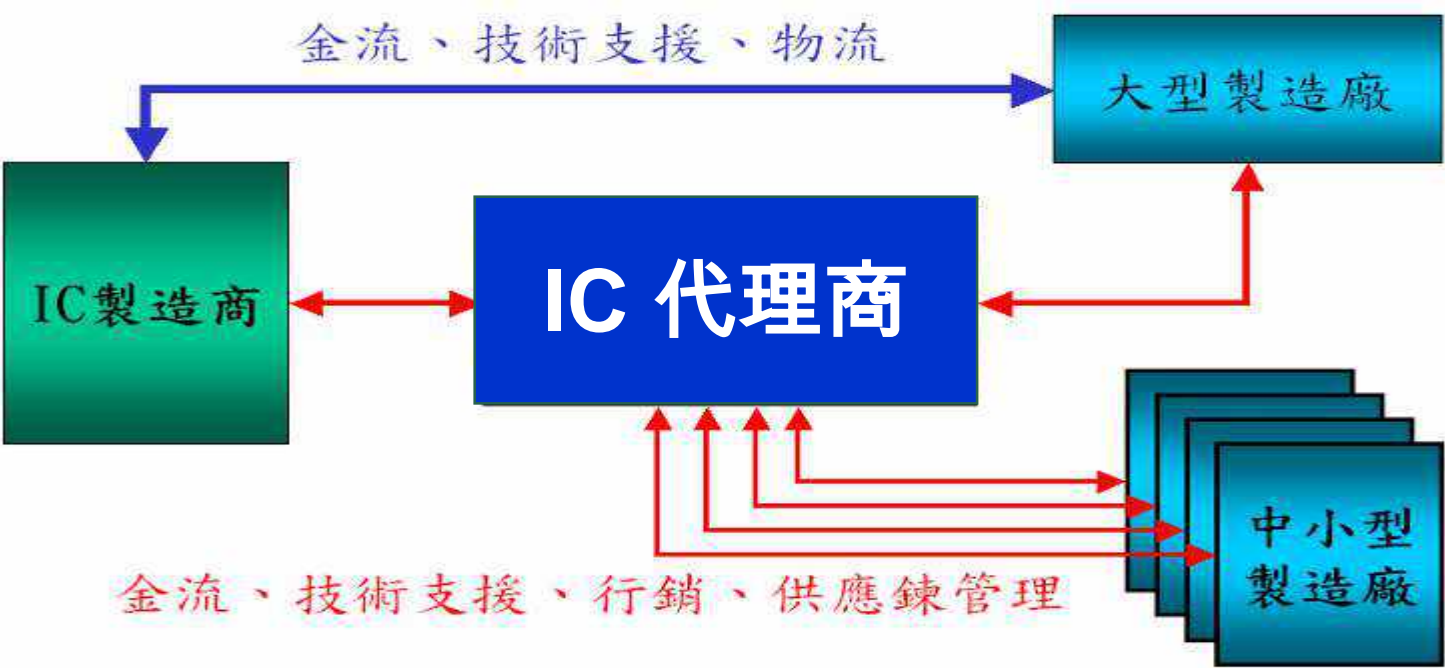
- ✓ **量大利薄**：代理商雖然能透過大量銷售創造營收，但每單位商品的利潤有限，導致必須不斷追求更高的銷售量才能維持獲利。
- ✓ **成本壓力**：行銷、通路、倉儲、物流、人力等固定成本不會隨毛利率下降而減少，反而可能因規模擴張而增加。
- ✓ **議價能力弱**：代理商通常受制於原廠的定價與合約條件，缺乏自主調整空間，難以提升毛利。

代理商面對市場變化因應策略

因市場規模大，採取低成本策略，有如量販店模式

跟隨製造商外移

降低營運成本

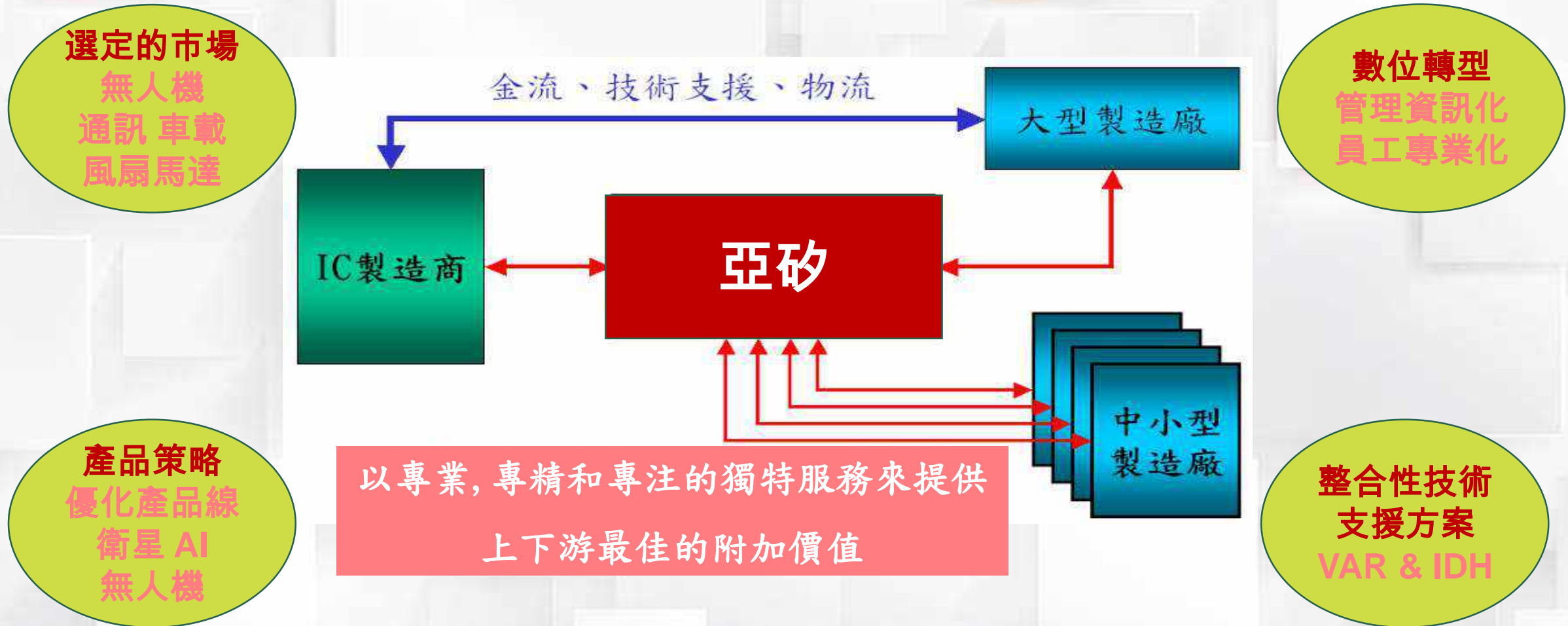


持續增加代理產品

上下游併購
同行整併
內部整合

亞矽面對市場變化因應策略

在選定的市場，採取差異化策略，提供精品店的商務模式



03

公司概況

公司簡介

亞矽科技自1986年四月創業以來，歷經三十九年持續耕耘與不斷地成長蛻變，以追求差異化及提高顧客價值為宗旨，迄今已成為大中華區聲譽卓著的**專業半導體通路代理商**



- 公司成立：April 1st, 1986
- 資本額：NT\$525M (US\$16.94M)
- 地點：HQ in Taipei Taiwan

Subsidiaries：Hong Kong and
Mainland China
Taichung

(R.O.C.)

- 負責人：蔡伯宜
- 員工人數：60+ Taiwan、40+ China
- IPO(in Taiwan)：August 10, 2001
- Stock Symbol：6113

亞矽科技代理產品



BOSCH



CORTINA



ENOVA



FUJITSU



SEQUANS



ISSI



GTC



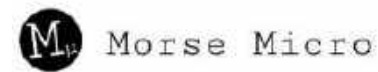
MTK



METANOIA



MICROCHIP



MORSE MICRO



REALTEK

ASEC Strategy



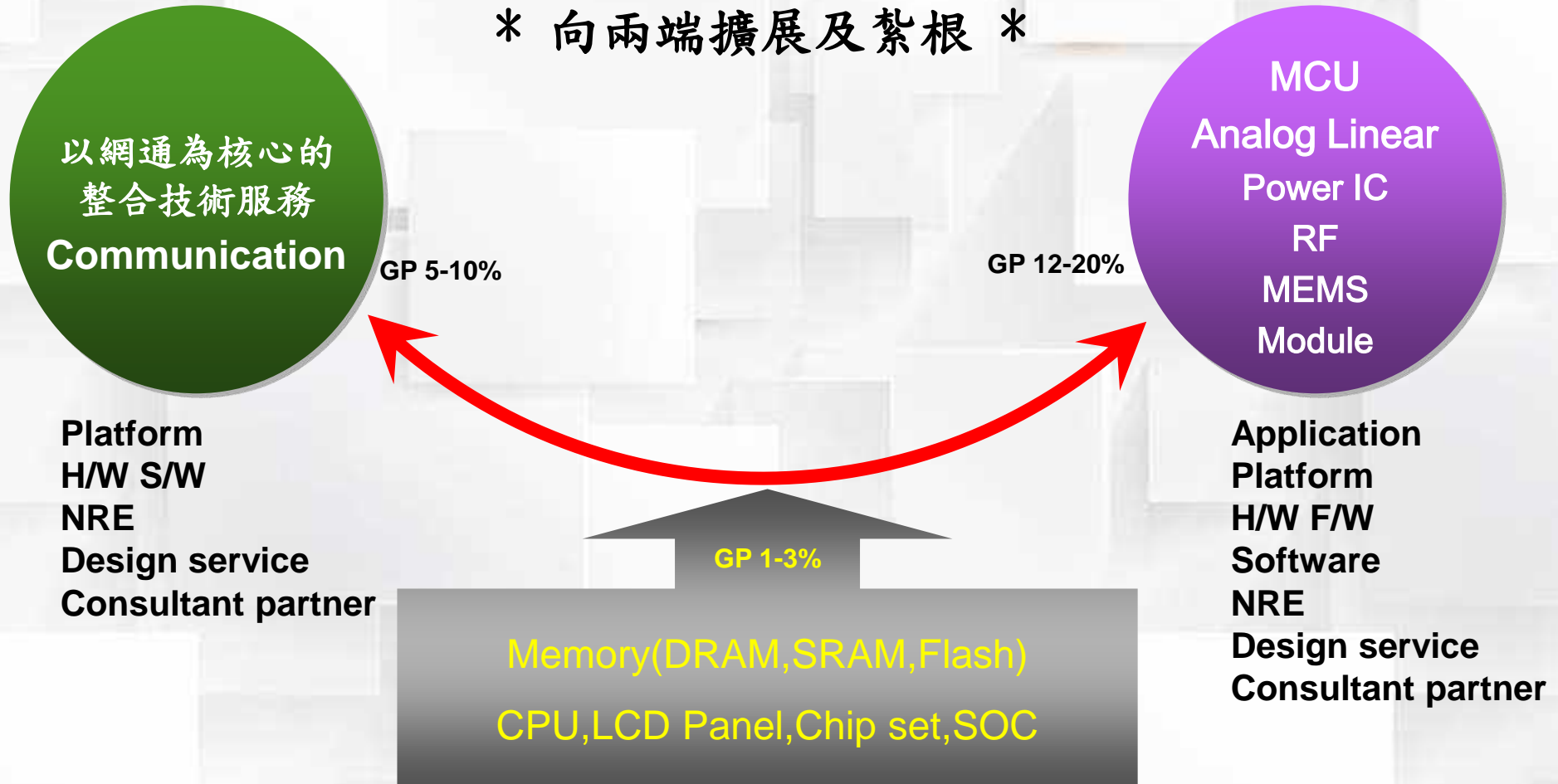
ASEC Strategy

決定競爭策略



ASEC Strategy

* 向兩端擴展及紮根 *



ASEC Strategy



營運效益

營運效能

吸收、獲得、延伸
最佳實行模範

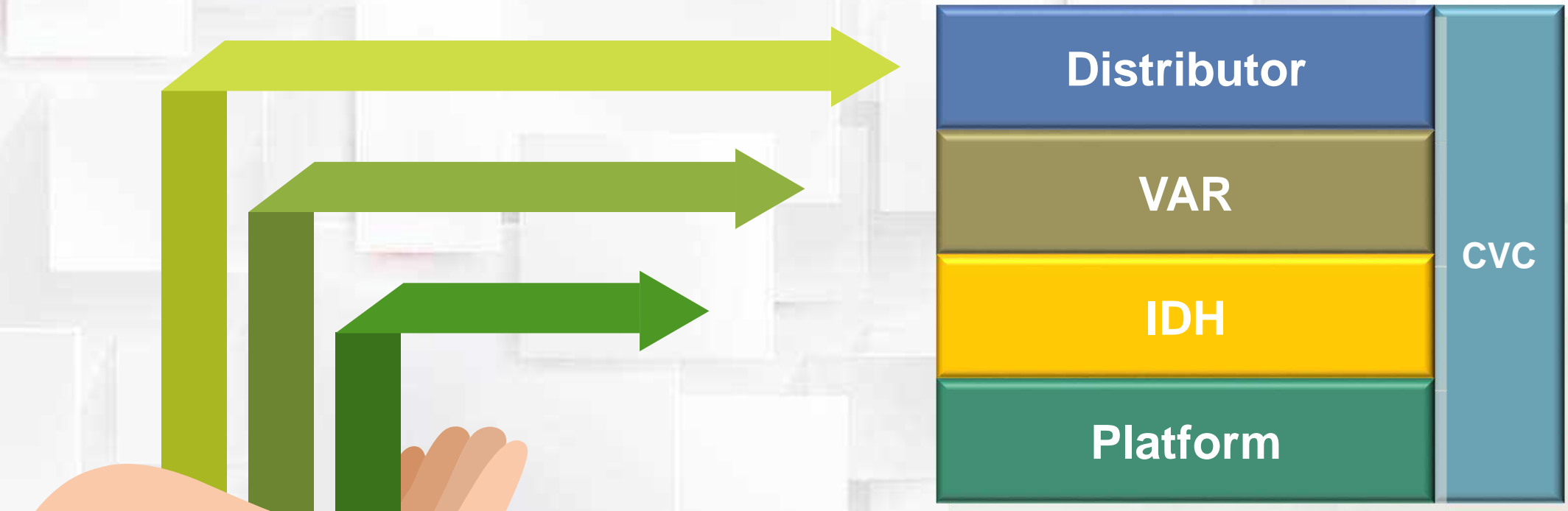
創造出獨特、可持續的
競爭優勢



同樣的事情上做
得比別人更好

提供差異化的服務
和價值與別人競爭

亞矽科技商業模式



Distributor

掌握供應商與客戶之需求，協助客戶創造更有彈性的運籌能力



VAR

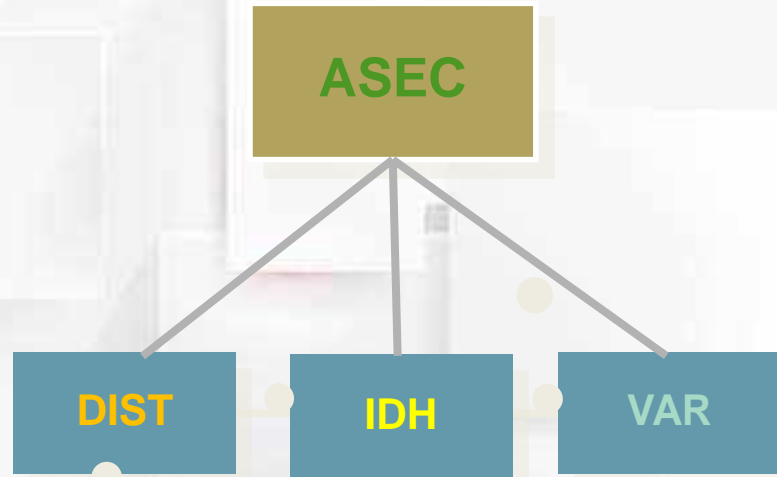
重視技術服務，提供客戶相關的增值專業技術服務



IDH

專注網通及馬達風扇等應用，陸續推出各種整合型解決方案

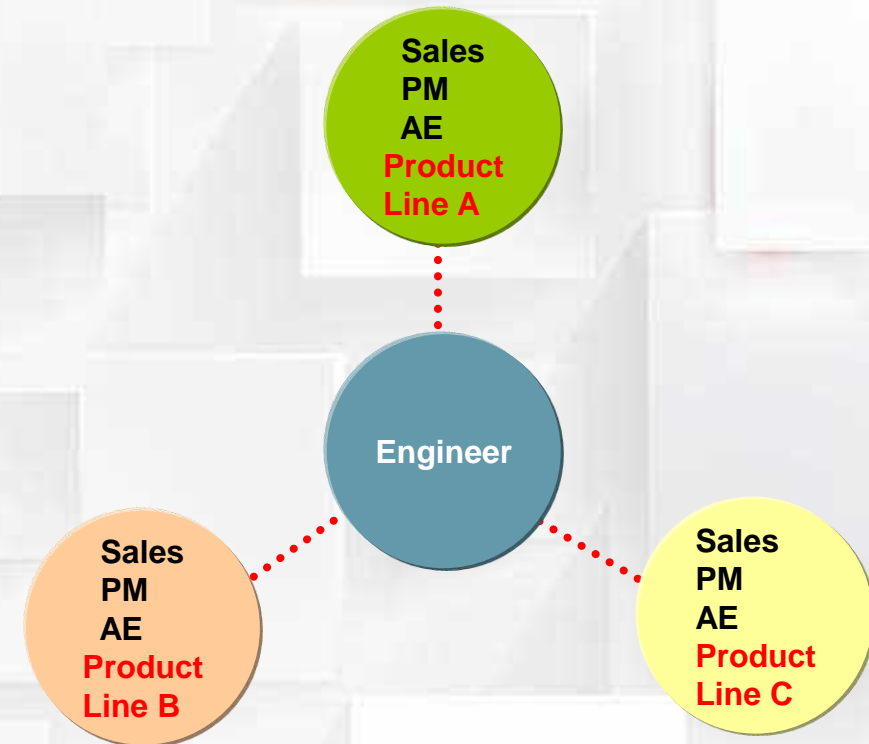
亞矽科技商業模式



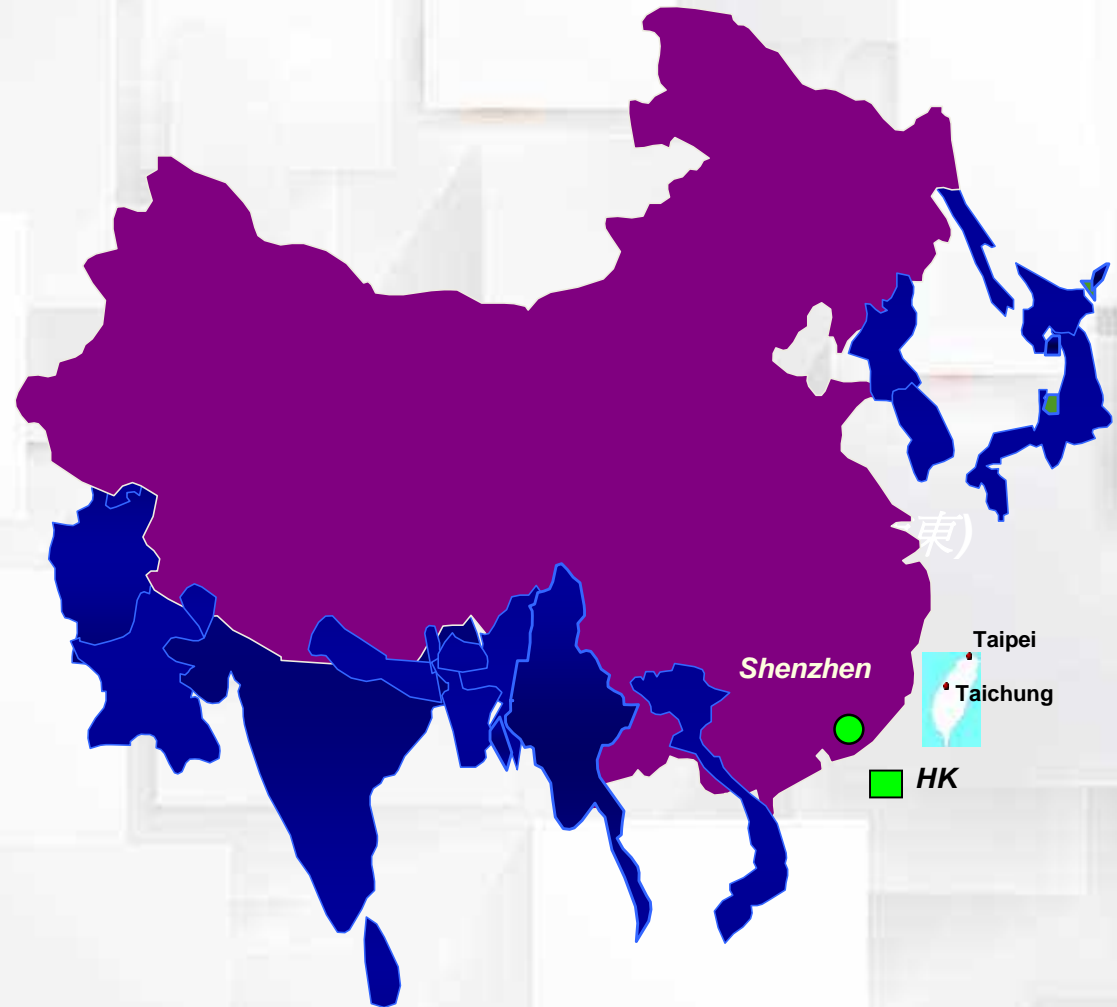
專業, 精緻, 塑造獨特的服務模式

差異化策略

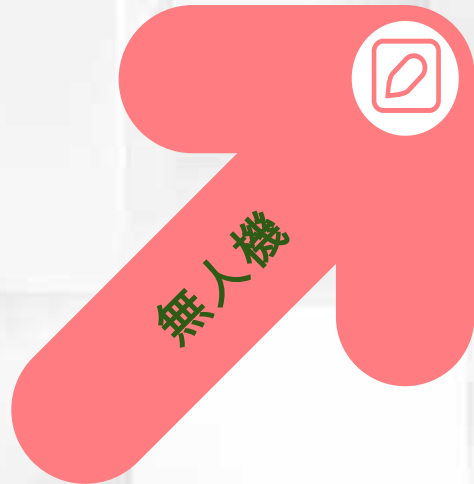
創造別人無可取代的地位



服務區域



選定的市場



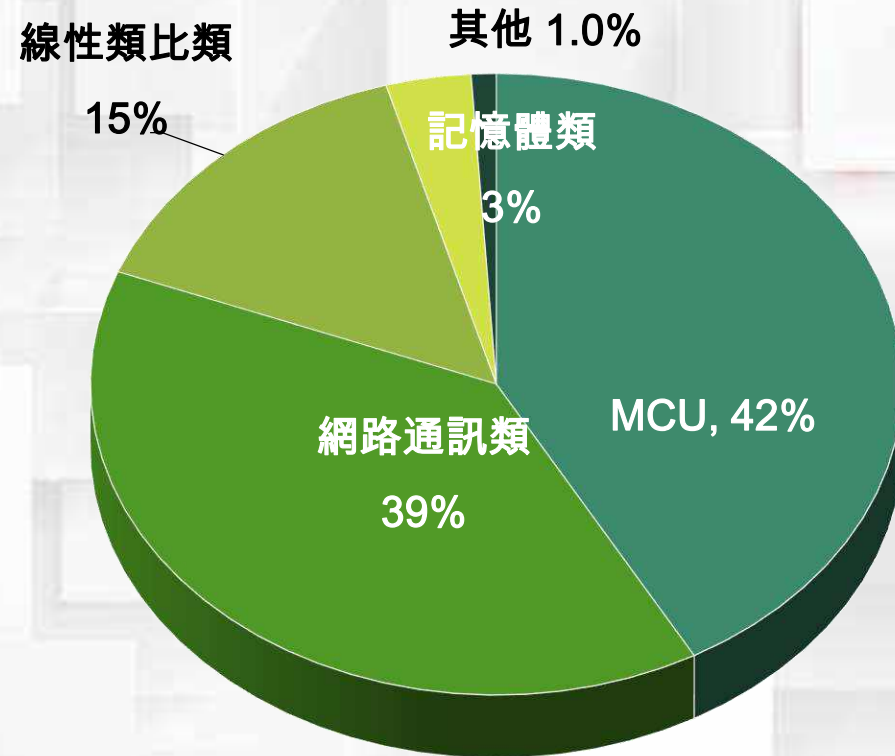
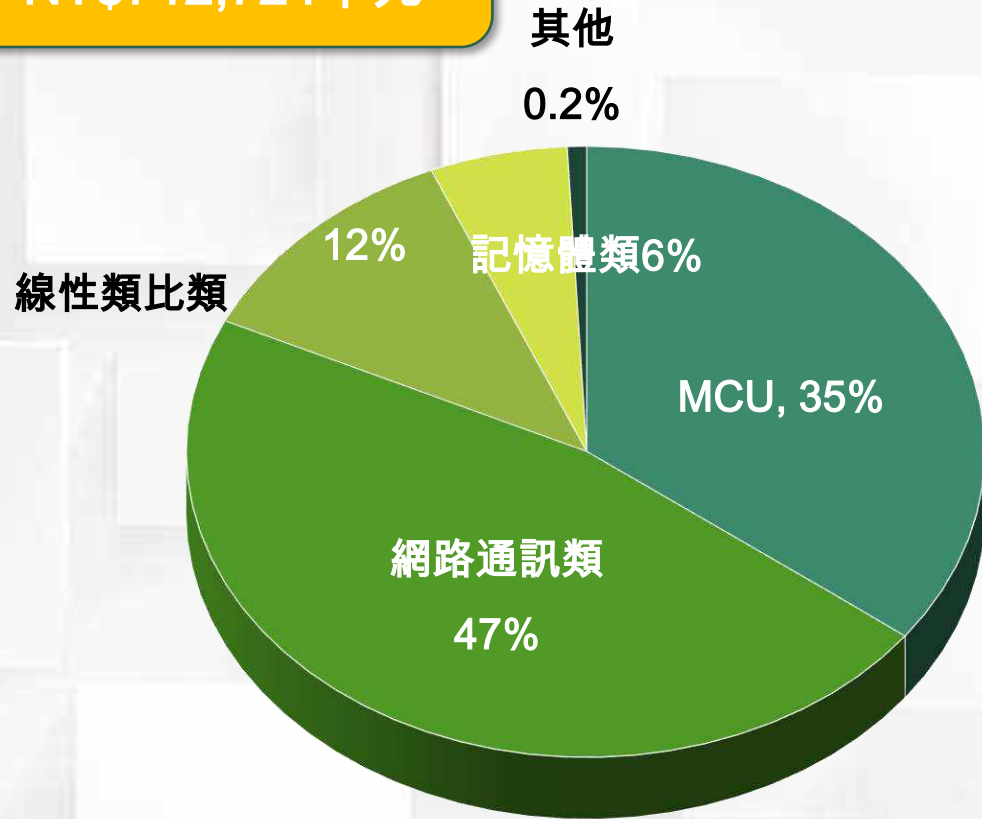
04

財務概況

產品項目營收比重

2024全年
NT\$712,724千元

2025 Q1-Q3
NT\$475,162千元



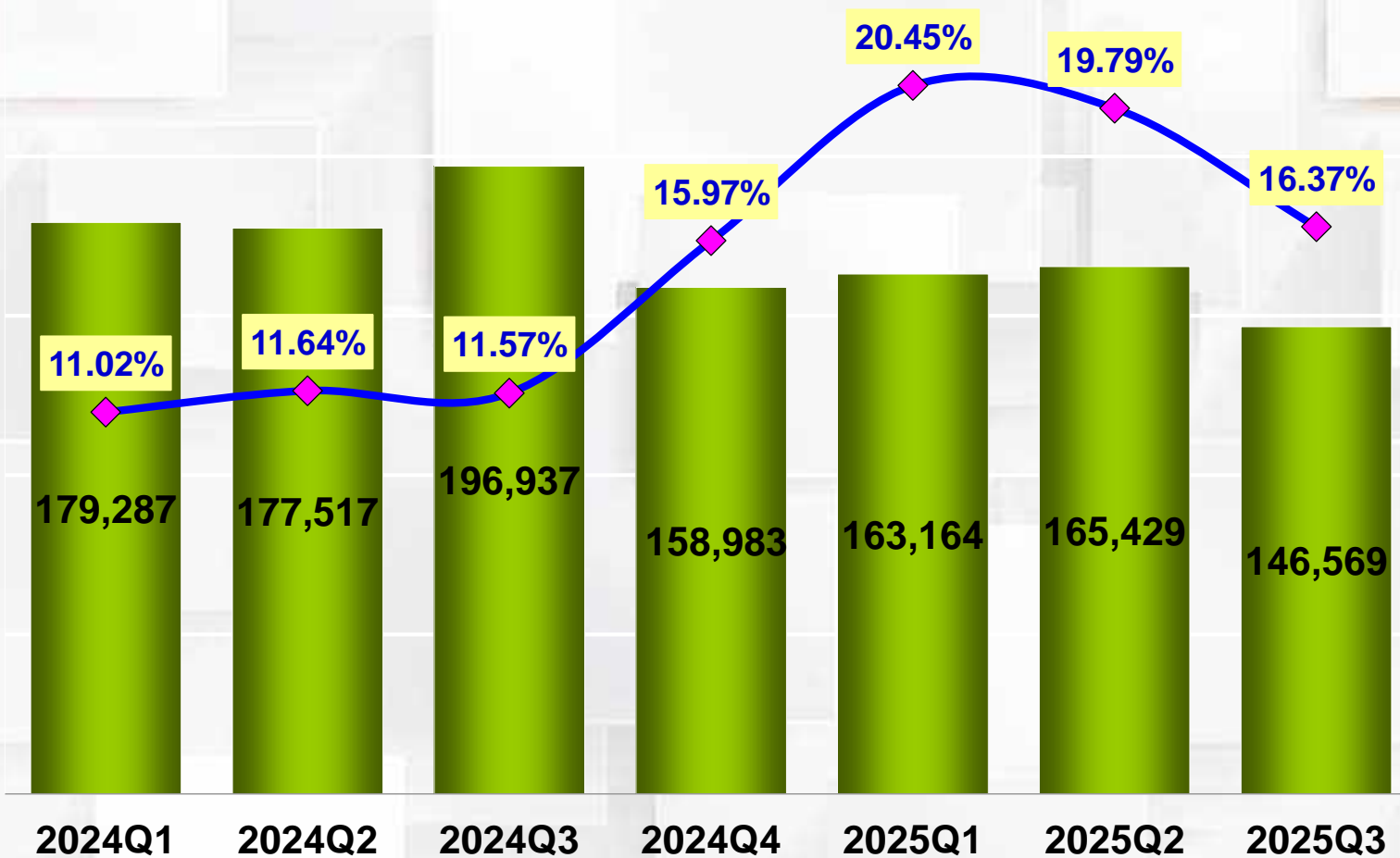
2025年前三季營運表現

單位：新台幣仟元	2025Q1		2025Q2		2025Q3		2025Q1-Q3	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	163,164	100.0	165,429	100.0	146,569	100.0	475,162	100.0
營業成本	129,801	79.6	132,698	80.2	122,577	83.6	385,076	81.0
營業毛利	33,363	20.5	32,731	19.8	23,992	16.4	90,086	19.0
營業費用	30,768	18.9	28,844	17.4	30,417	20.8	90,029	19.0
營業淨利(損)	2,595	1.6	3,887	2.4	(6,425)	(3.9)	57	0.0
營業外收入及支出	3,932	2.4	(14,251)	(8.6)	3,765	2.6	(6,554)	(1.4)
稅前淨利(損)	6,527	4.0	(10,364)	(6.3)	(2,660)	(1.8)	(6,497)	(1.4)
所得稅費用(利益)	76	0.1	58	0.0	67	0.1	201	0.0
本期淨利(損)	6,451	3.9	(10,422)	(6.3)	(2,727)	(1.9)	(6,698)	(1.4)
基本每股盈餘(虧損)		0.12		(0.20)		(0.05)		(0.13)

2025 VS. 2024年前三季營運成果

單位：新台幣仟元	2025 Q1-Q3		2024 Q1-Q3		年成長
	金額	%	金額	%	%
營業收入	475,162	100.0	553,741	100.0	(14.2)
營業成本	385,076	81.0	490,529	88.6	(21.5)
營業毛利	90,086	19.0	63,212	11.4	42.5
營業費用	90,029	19.0	93,521	16.9	(3.7)
營業淨利(損)	57	0.0	(30,309)	(5.5)	100.2
營業外收入及支出	(6,554)	(1.4)	20,851	3.8	(131.4)
稅前淨利(損)	(6,497)	(1.4)	(9,458)	(1.7)	31.3
所得稅費用(利益)	201	0.0	314	0.1	(36.0)
本期淨利(損)	(6,698)	(1.4)	(9,772)	(1.8)	31.5
基本每股虧損		(0.13)		(0.19)	

季營收與毛利率趨勢



■ 營收 ◆ 毛利率

✓ 近二年度營業收入呈現下滑趨勢: 因中國大陸市場需求低迷及產品策略調整所致。

✓ 營業毛利率卻呈現上升趨勢: 因公司銷售策略是在利基市場以提供技術支持與整合性方案來提升附加價值。

2025年第三季資產負債表

單位：新台幣仟元	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
資產總額	1,029,567	792,640	750,390
現金及約當現金	357,444	216,432	191,167
應收票據及帳款淨額	104,420	87,605	82,366
存貨淨額	90,274	77,925	69,027
負債總額	442,943	261,974	217,275
短期借款	180,000	0	0
應付票據及帳款	79,663	67,910	54,763
股東權益總額	586,624	530,666	533,115
重要財務指標			
應收帳款收款天數	60	55	56
存貨週轉天數	79	74	73
應付帳款付款天數	67	62	59
流動比率(倍)	2.30	3.31	4
股東權益報酬率(%)	4.42	(1.43)	(1.60)
負債比(%)	43.02	33.05	28.95

2025 VS. 2024年第三季資產負債表

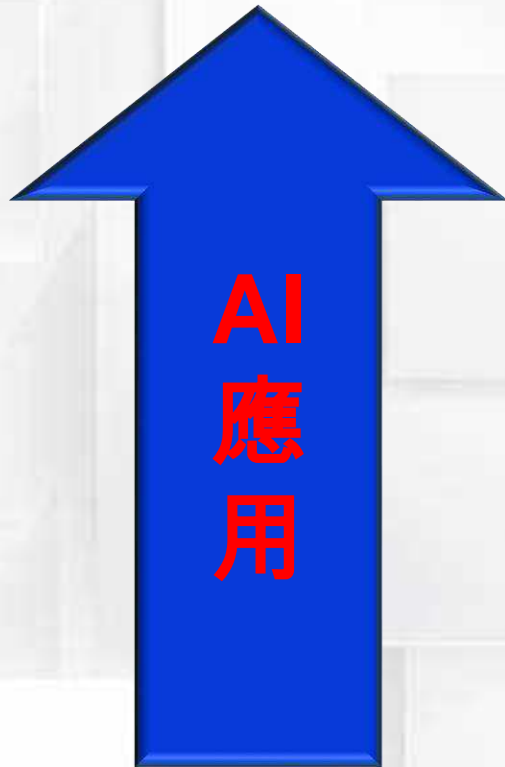


單位：新台幣仟元	2025 Q3	2024 Q3
資產總額	750,390	1,073,319
現金及約當現金	191,167	328,196
應收票據及帳款淨額	82,366	131,288
存貨淨額	69,027	134,609
負債總額	217,275	502,323
短期借款	0	180,000
應付票據及帳款	54,763	114,937
股東權益總額	533,115	570,996
重要財務指標		
應收帳款收款天數	56	86
存貨週轉天數	73	107
應付帳款付款天數	59	72
流動比率(倍)	4	2.08
股東權益報酬率(%)	(1.60)	(2.22)
負債比(%)	28.95	46.80

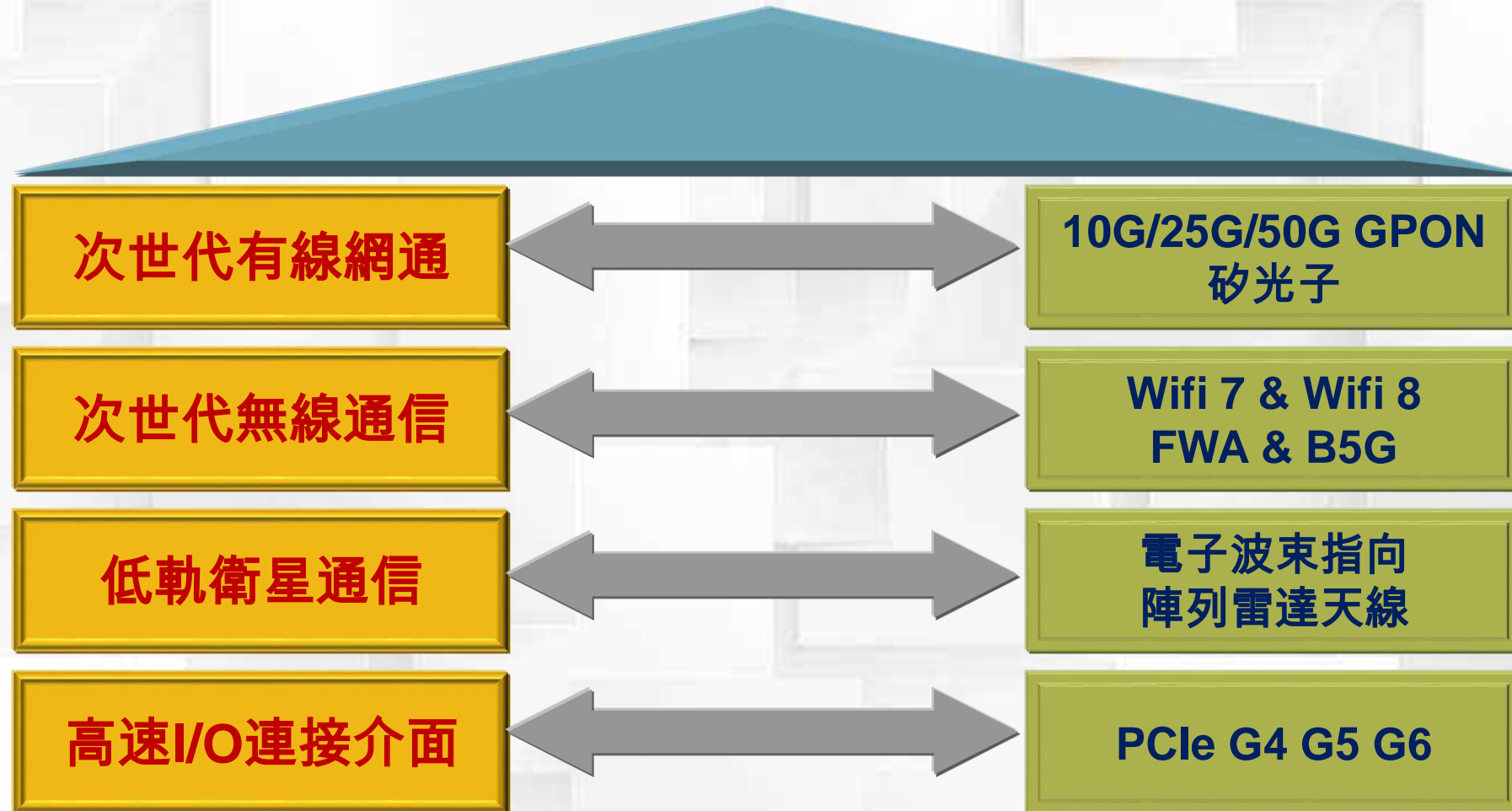
05

未來展望

AI應用加速帶動相關產業成長



亞矽在AI浪潮下的佈局



技術整合服務的再進化



- 深化網通 **10G/25G/50G GPON**、**Wi-Fi 6/7**、**B5G & FWA** 等技術支援能力。
- 深耕**MCU**微處理器、**Sensor**感測器與車載等方案。
- 深耕**馬達與風扇**市場，持續與原廠密切合作，提供客戶相關產品整合技術支援服務。
- 在**無人機**: 透過亞矽相關產品線以及強而有力的技術支援能力，來提供最佳的整合性方案。

持續打造營運優勢

新產品開發

在我們選定的市場，補強**新技術新產品**，提供客戶更高的附加價值及競爭力。

數位化/AI管理

透過**數據管理**，**流程再造**加上**AI科技**的輔助與應用全面提升公司的效能與競爭力。

ESG

以**永續經營策略**提供ASEC在產業的信任與重要度，並創造長期競爭優勢。

Q & A



THANK YOU

亞矽低碳永續發展策略

亞矽董事會已於2022年10月決議通過成立「ESG委員會」，推動永續發展策略，以達成永續目標。並於今(民國114)年5月亞矽委託法標國際認證股份有限公司，依據ISO 14064-3:2019標準執行溫室氣體盤查，順利通過查證。

